

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-004

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称“光学半导体”），为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额：租赁本金人民币 100,000,000.00 元及利息等。已实际为光学半导体提供的担保余额为 23,713.03 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保是否需提交股东大会审议：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称“光学半导体”）拟以其拥有的部分生产设备通过售后回租方式与芯鑫融资租赁有限责任公司（简称：芯鑫融资租赁）开展设备融资租赁业务并签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》等相关合同，合同租赁本金金额为人民币 10,000 万元，年利率为浮动利率，首期执行年化利率 4.41%，租赁期限共 36 个月。租赁期内，光学半导体以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向芯鑫融资租赁支付租金和费用。

公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。租赁期限内，设备所有权属于芯鑫融资租赁，租赁期届满，光学半导体以留购价人民币 100 元（含增值税款）购回租赁资产所有权。

本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司提供担保的议案》，本次担保事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司

成立日期：2018 年 10 月 23 日

统一社会信用代码：91330481MA2BC1447K

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号

法定代表人：葛文志

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；5G 通信技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；新材料技术推广服务；科技中介服务；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：光学半导体为公司的全资子公司。

浙江美迪凯光学半导体有限公司 2022 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年三季度未经审计财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2023 年三季度
资产总额	126,446.54	135,055.24
负债总额	35,558.78	47,260.73
资产净额	90,887.76	87,794.51
营业收入	23,405.64	14,624.10
净利润	1,468.42	-3,093.26

光学半导体为公司的全资子公司，截至公告披露日，光学半导体不存在失信被

执行的情形，不属于失信被执行人。

三、交易对方基本情况

企业名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

企业性质： 有限责任公司(中外合资)

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室

法定代表人： 孔令夷

注册资本： 1320949.0321 万元人民币

成立时间： 2015 年 8 月 27 日

统一社会信用代码： 9131011535067083X5

经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东及实际控制人：无实际控制人

据中国执行信息公开网的查询结果，交易对方不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

芯鑫融资租赁与公司及光学半导体不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

（一）本次交易相关《售后回租赁合同》主要内容

1、出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

2、承租人：浙江美迪凯光学半导体有限公司

3、租赁物：镀膜机等设备，根据 2023 年 9 月末财务数据，原值 13,108.36 万元，净值 10,784.15 万元。

4、租金：本金 100,000,000.00 元及利息等。按照合同签署日概算的租金总额为 107,310,263.28 元（含增值税款），租金总额的具体金额以甲方向乙方出具的《租金支付通知书》中金额加总为准。每期租金的具体金额以《租金支付通知书》为准。

5、租赁期限：36 个月

6、起租日：起租日为芯鑫融资租赁有限责任公司根据《所有权转让协议》约

定支付租赁物协议价款当日。

7、租金支付及年利率：等额租金季度后付。年利率为浮动利率，首期执行年化利率 4.41%。

(二) 本次交易相关《保证合同》的主要内容

1、债权人：芯鑫融资租赁有限责任公司

2、债务人：浙江美迪凯光学半导体有限公司

3、保证人：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

4、保证担保的范围：(1) 全部租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；

(2) 债权人实现担保权利而发生的所有费用（包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等）；(3) 因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；(4) 生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；(5) 主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

保证人对债务人和债权人签署的《售后回租赁合同》项下的债务负有连带责任。

5、担保的方式：连带责任保证担保

6、担保期限：自《售后回租赁合同》（包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议，统称“主合同”）约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

7、担保金额：10,000 万元本金及利息等。

本次担保的相关协议尚未正式签订，具体以实际签订的协议为准。

五、担保的原因和合理性

本次担保事项是为了满足光学半导体业务发展的需要，保证其流动资金周转及日常经营活动的正常开展，被担保人系本公司的全资子公司，当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

六、董事会意见

2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全体董事出席本次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次向光学半导体开展融资租赁业务提供担保，有利于满足其经营需求，保障各项业务顺利开展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、累计对外担保

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额47,908.98万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为30.92%、25.10%，均为公司对全资子公司、控股子公司的担保。

截至本公告日，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2024年2月7日